

# 熱硬化Cuペースト

NEW

## Thermo-setting Cu Paste

### ●大気中で硬化可能

Curable in the Air

### ●低温硬化で高い導電性

High Conductivity Despite Curing at Low Temperature

### ●高い酸化耐久性

High Oxidation Resistance



雰囲気 Atmosphere	Air	
推奨硬化条件 Curing condition	>130°C/30min	
抵抗率( $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ ) Resistivity	20~40	
密着性(クロスカット試験) Adhesion property(Cross cut test)	Glass,PET,PC,Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> etc	
耐久性 (抵抗変化率) Durability (Change rate of resistivity)	高温高湿試験(60°C90%,500hr) High-Temperature/Humidity test	<10%
	高温放置試験(90°C,500hr) High temperature storage test	<10%
	冷熱衝撃試験 (-40~85°C,30min keep,100cycle) Thermal shock test	<10%

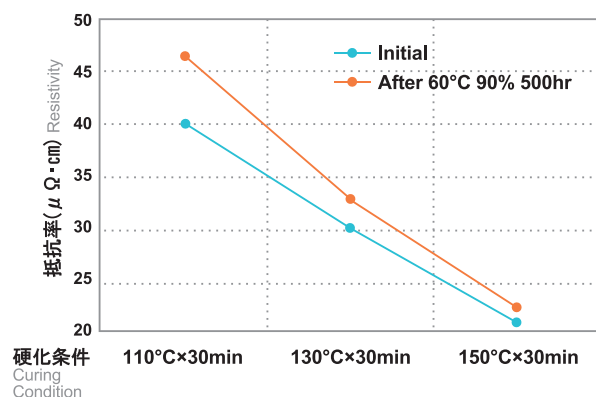
### 低抵抗化

#### Low Resistivity



### 硬化条件と耐久性

#### Curing Conditions and Durability



Noritake

#### Contact us

株式会社  
ノリタケカンパニーリミテド  
電子ペースト事業部

〒470-0293 愛知県みよし市三好町東山300番地

E-mail : emsd@n.noritake.co.jp

TEL : (0561)34-1272

FAX : (0561)34-4903